# 合规科技资讯平台

## 提供内容备注

金管局欢迎合规科技界提供内容(包括研究报告、用例及活动等)。如有意向「合规科技资讯平台」提供内容，请以电邮方式寄交 regtech@hkma.gov.hk。

提供内容时，请载明以下各项资料(下称「相关资料」)：

- 作者资料：作者全名
- 刊物资料：出版商名称(如与作者不同)及出版日期
- 内容描述：刊物主题及其与合规科技的相关性
- 刊物类别：合规科技新闻/合规科技发展/合规科技活动/合规科技相关连结
- 提供者资料：全名、联络方式(包括电邮及电话号码)、职衔及所属机构

请只提供由阁下/贵机构作为其知识产权(包括但不限于版权)拥有人的内容。请注意，金管局不能保证阁下/贵机构提供的内容会被刊载。

如阁下/贵机构(下称「提供者」)向金管局提供内容，即表示提供者承认已细阅以下条款及条件，并且提供者会被当作已无条件接受及同意受以下条款及条件约束。如提供者不同意以下条款及条件，则请勿向金管局提供任何内容。

1. 提供者承认及明白，提供者提供的讯息、文件、材料及 / 或报告(统称「内容」)及相关资料可能会(全部或局部)在「合规科技资讯平台」发布。提供者进一步承认及明白，发布内容或其任何部分的决定，纯属香港金融管理局 (下称「金管局」)所有。金管局保留权利删除在「合规科技资料平台」所发布的任何内容。

2. 提供者向金管局陈述及保证 (a) 相关资料真实及准确；(b) 提供者是内容的知识产权(包括但不限于版权)的拥有人；(c) 提供内容并不侵犯任何人的任何知识产权(包括但不限于版权)及其他权利，亦不违反任何保密责

任(无论因法律、协议或其他原因所产生)，并且遵守适用法律；及 (d) 金管局就本条款及条件所拟定的目的来使用内容或其任何部分(包括但不限于保留、编辑、改编及复制内容)并不或不会侵犯任何人的任何知识产权(包括但不限于版权)及任何其他权利，亦不会违反任何保密责任(无论因法律、协议或其他原因所产生)。对于金管局可能因提供者失实陈述或因内容侵犯任何第三方权利而所招致的所有申索、损失、损害、费用、支出或责任(无论直接或间接)，提供者须在金管局提出要求时向金管局作出十足的弥偿并使金管局免受损失。

3. 提供者授予金管局为在「合规科技资讯平台」发布及其他相关与附带目的使用内容或其任何部分(包括但不限于保留、编辑、改编及复制内容)的权利。提供者同意金管局在「合规科技资讯平台」发布内容或其任何部分前无需提供者给予同意，并且金管局无需向提供者支付任何收费或费用。

4. 本条款及条件的英文版与本条款及条件的中文版如有差异，以英文版为准。

5. 本条款及条件受中华人民共和国香港特别行政区(「香港」)法律管辖，并须按照该等法律诠释；提供者同意接受香港法院的专属司法管辖。

6. 如阁下代表某实体提供内容，则阁下陈述及保证阁下有权代表该实体无条件接受本条款及条件，并使该实体受本条款及条件约束(在本条款中，凡提述「提供者」均指该实体)。

**个人资料收集声明**

金管局在提供者提供内容时向其收集的个人资料将会用作与「合规科技资讯平台」的运作相关的用途，包括任何必要的行政管理工作、跟进联络、统计及服务监察，以及金管局的私隐政策声明下的相关目的。除非法律允许或有规定，

否则个人资料不会未经阁下同意被用作任何其他用途，亦不会予以披露或转移。.

提供个人资料属自愿性质。如未能提供所要求的个人资料，或所提供资料不正确或不完整，金管局或未能考虑或处理阁下提供的内容。

阁下有权要求查阅及更正本局持有的阁下的个人资料。如阁下希望行使这项权利，请以电邮 (publicenquiry@hkma.gov.hk) 联络本局的「个人资料私隐主任」。